



ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

(股份代號：00522)

二零零五年未經審核中期業績公佈 截至二零零五年六月三十日止六個月

ASM 於二零零五年上半年創造超卓成績

- 穩佔全球裝嵌及包裝設備業第一位
- 於過去十二個月進一步拉闊與業內第二位之差距
- 儘管第一季度行業經營環境困難，每股盈利仍創出歷來六個月期間第六高水平

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣悅地宣佈二零零五年中期業績如下：

業績

謹此欣然報告，ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASM」）於截至二零零五年六月三十日止六個月之營業額為港幣1,457,183,000元，較去年同期的港幣2,280,710,000元下跌36.1%，亦較前六個月之港幣1,548,220,000元下跌5.9%。期內，集團綜合除稅後溢利為港幣323,591,000元，較二零零四年同期下跌47.2%，亦較前六個月下跌16.9%。期內每股基本盈利為港幣0.84元（二零零四年：港幣1.59元）。

派息

鑑於集團擁有充裕的流動資金及穩步增加的股本基礎，董事會現建議派發中期股息每股港幣0.50元（二零零四年：港幣0.45元）及特別股息每股港幣0.20元（二零零四年：港幣0.55元）。此派息政策乃貫徹集團於過去數次業績公佈時明確指出將剩餘現金回饋予股東的審慎政策，並預留適量的股東資金作營運之用。憑藉過去數年在微電子市場所建立的穩固基礎，集團未來將致力透過其多元化及高性能的產品擴大市場佔有率，積極加快本體增長。集團在短期內沒有重大現金開支，並於過去五年持續從營運產生顯著正現金流量。

集團將於二零零五年八月十七日至八月二十四日，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派是次中期股息及特別股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零零五年八月十六日下午四時前，送達香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下公司股份登記處秘書商業服務有限公司。中期股息及特別股息將於二零零五年八月二十九日左右派發。

簡明綜合收益報表

		截至六月三十日止六個月	
		二零零五年	二零零四年
		(未經審核)	(未經審核)
	附註	港幣千元	港幣千元
營業額	2	1,457,183	2,280,710
銷貨成本		(802,860)	(1,264,496)
毛利		654,323	1,016,214
其他經營收益		13,077	8,481
銷售費用		(138,812)	(156,605)
一般管理費用		(64,848)	(66,211)
研究及發展淨支出		(119,015)	(142,447)
經營溢利		344,725	659,432
財務費用		(3)	(5)
除稅前溢利		344,722	659,427
稅項	4	(21,131)	(46,194)
本期間溢利		323,591	613,233
中期股息		192,634	172,561
特別股息		77,054	210,909
股息總額		269,688	383,470
每股盈利	5		
— 基本		港幣0.84元	港幣1.59元
— 攤薄		港幣0.84元	港幣1.59元

簡明綜合資產負債表

	二零零五年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零四年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	793,088	772,006
預付租賃費用	9,143	9,370
遞延稅項資產	1,788	1,999
	<u>804,019</u>	<u>783,375</u>
流動資產		
存貨	670,043	554,830
貿易及其他應收賬款	836,730	642,223
預付租賃費用	446	446
銀行結餘及現金	520,531	763,359
	<u>2,027,750</u>	<u>1,960,858</u>
流動負債		
貿易及其他應付賬款	601,853	461,284
應付稅項	112,329	103,099
	<u>714,182</u>	<u>564,383</u>
流動資產淨值	<u>1,313,568</u>	<u>1,396,475</u>
	<u>2,117,587</u>	<u>2,179,850</u>
資本及儲備		
股本	38,527	38,527
股息儲備	269,688	404,532
其他儲備	1,805,816	1,734,406
股東資金	<u>2,114,031</u>	<u>2,177,465</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	3,556	2,385
	<u>2,117,587</u>	<u>2,179,850</u>

附註：

1. 會計政策之主要改變

本簡明財務報表所應用之會計政策與本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之週年財務報表所採納者完全一致，惟以下所述者除外。

於本期間，集團首次採用由香港會計師公會所頒佈的一系列新訂的香港財務報告準則、香港會計準則及解釋（以下全部簡稱「新訂香港財務報告準則」），該等準則於二零零五年一月一日或之後開始的會計期間生效。本集團因採用新訂的香港財務報告準則而改變以下的會計政策，對本期及過往的會計年度的財務表現之編製及呈列方式構成影響。

以股份支付的支出

於本期間，集團採用了香港財務報告準則二「以股份支付的支出」，規定集團以股份或股權換購貨品或換取服務（權益結算交易）、或以某數量之股份或股權換取等值之其他資產（現金結算交易），均需確認為開支。香港財務報告準則二對本集團之主要影響為根據僱員股份獎勵制度（「制度」）授予董事及僱員之股份開支。在採用香港財務報告準則二之前，該制度之費用以預期將會發行之股份之票面值，於有關董事及僱員提供服務期間確認為開支。

採用香港財務報告準則二之後，該制度之費用乃參照股份授予當日之公平價值計算，並根據授予股份之條款作調整，在有關之歸屬期間於收益報表中攤銷。

本集團遵照香港財務報告準則二，計算二零零五年一月一日或之後授予之股份。至於二零零五年一月一日前授予之股份，即二零零二年十一月七日或之前授予之股份，及二零零二年十一月七日之後授予並於二零零五年一月一日或之前已歸屬之股份，本集團不會遵照香港財務報告準則二計算，只會根據該準則列出的過渡期條款列賬。由於本集團沒有於二零零二年十一月七日後授予並於二零零五年一月一日尚未歸屬之股份，因此沒有追溯重報的需要。

然而，香港財務報告準則二之採用對本集團二零零五年一月一日後的會計期間起了重大的影響。於二零零五年二月根據制度授出股份之估計公平價值港幣26,018,000元（截至二零零四年六月三十日止六個月：無），已於本期間之收益報表內扣除，並計入相關之股東權益。

2. 分類資料

業務分類

	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核) 港幣千元	二零零四年 (未經審核) 港幣千元
營業額		
設備	1,173,650	1,990,955
引線框架	283,533	289,755
	<u>1,457,183</u>	<u>2,280,710</u>

業績		
設備	301,406	642,801
引線框架	35,644	13,944
	<u>337,050</u>	<u>656,745</u>
利息收益	7,675	2,687
	<u>344,725</u>	<u>659,432</u>
經營溢利	(3)	(5)
財務費用		
	<u>344,722</u>	<u>659,427</u>
除稅前溢利	(21,131)	(46,194)
稅項		
	<u>323,591</u>	<u>613,233</u>

地區分類

	營業額	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核)	二零零四年 (未經審核)
	港幣千元	港幣千元
中國大陸	335,226	432,003
台灣	265,313	527,954
馬來西亞	188,441	290,538
韓國	122,187	162,509
香港	118,974	154,006
泰國	96,482	148,724
菲律賓	93,198	262,885
歐洲	75,151	31,214
新加坡	69,357	112,358
美國	62,911	100,671
日本	17,985	21,302
印尼	9,683	28,994
其他	2,275	7,552
	<u>1,457,183</u>	<u>2,280,710</u>

3. 折舊

於本期間內，集團的物業、廠房及設備之折舊為七千四百四十萬港元(二零零四年六月三十日止六個月為一億一千七百三十萬港元)。

4. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核) 港幣千元	二零零四年 (未經審核) 港幣千元
稅項包括：		
香港利得稅	15,254	44,687
在其他司法權區之稅項	4,489	4,612
	<u>19,743</u>	<u>49,299</u>
遞延稅項支出(抵免)	1,388	(3,105)
	<u>21,131</u>	<u>46,194</u>

香港利得稅是按本期間內估計應課稅溢利以稅率17.5%(二零零四年六月三十日止六個月為17.5%)計算。

其他司法權區之稅項乃根據有關司法權區個別之現行稅率計算。

集團新加坡分部獲當地政府頒發「生產總部」榮譽，根據新加坡稅務當局授與之稅務獎勵計劃，本集團在新加坡生產之若干半導體設備及物料新產品所產生之溢利毋須課稅，自二零零一年一月一日起十年內，在新加坡分部履行若干條件下，該等優惠將為有效。

集團於中華人民共和國(「中國」)經營之部份附屬公司因獲免稅期及稅務優惠而豁免本期間的中國所得稅。

遞延稅項支出(抵免)主要是來自稅項折舊與計入財務報表之折舊費用之暫時性差距的稅務影響。

5. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 (未經審核) 港幣千元	二零零四年 (未經審核) 港幣千元
計算每股基本及攤薄盈利之股東應佔溢利	<u>323,591</u>	<u>613,233</u>
	股份之數量(以千位計)	
計算每股基本盈利之普通股加權平均股數	385,269	384,998
來自僱員股份獎勵制度之潛在攤薄影響	<u>1,263</u>	<u>1,266</u>
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均股數	<u>386,532</u>	<u>386,264</u>

業務回顧

如集團二零零四年全年業績公告所述，受惠於二零零四年上半年利好的經濟環境，ASM 的營業額及盈利均創歷來六個月期間新高，惟裝嵌設備行業的需求於第三季度中期開始受到影響，半導體裝嵌設備市場由全面性的迅速增長，轉為對特定性能及包裝需求的選擇性採購。於第四季度，所有企業均熱切地期待著春季的來臨。

於二零零五年二月發佈的全年業績報告中，我們在展望部份所提及與產能相關設備的急購訂單證實為行業復甦的正確指標。裝嵌及包裝設備行業自二零零五年三月起重拾升軌，而 ASM 新增訂單數目於過去數月間亦錄得強勁的增長。由於二零零五年第一季度的付運數字已達最低點(相對過去八個季度而言)，行業的復甦情況至今符合大部份分析員所預期。

事實上，於過去兩次行業週期中，各項經濟指標、消費者開支及政局均沒有重大變動。二零零五年，電子產品如個人電腦、手提電話、數碼相機及多媒體產品的需求亦持續增長。因此，半導體產業協會(SIA)於其春季報告中亦把二零零五年半導體銷售的預測由下跌百分之二調高至增長百分之六。不幸的是，處於電子產業鏈終端的電子產品企業，為使供應鏈上游的產品供求正常化而作出存貨水平調整，令終端設備供應商出現大幅波動。ASM 作為業內最大的供應商，儘管擁有多元化的產品組合及廣泛的客戶基礎，亦在此波動中未能免疫。

承接集團近年的卓越表現，本年度 ASM 再度超越同儕並提升佔有率，在穩佔裝嵌及包裝設備行業的第一位之餘，更於過去十二個月進一步拉闊與最接近競爭對手的差距。於過去六個月，集團錄得營業額一億八千七百萬美元及純利三億二千三百六十萬港元。於過去六個月，資本回報率及銷售利潤率分別為16.3%及23.1%。隨著第二季度產量開始逐漸追上需求，上半年度的訂貨對付運比率為1.11，於二零零五年六月三十日的未完成訂單總值為八千萬美元(於二零零四年十二月三十一日為六千三百萬美元)。

有此傑出的成績主要由於集團多年來透過產品及市場多元化、有效的成本結構及成功推出具備先進技術的創新產品。於二零零五年上半年，我們的五大客戶共佔集團營業額27.9%，所有客戶的銷售額佔集團營業額均不超過10%，足以證明我們的市場多元化策略之成功。此外，集團的銷售廣泛分佈各地，當中中國大陸已超越其他地區成為集團最主要的市場，佔營業額的23.0%，台灣市場緊隨其後佔18.2%，足以反映業內的投資氣候。

受惠於市場需求增長，集團於中國、新加坡及馬來西亞引線框架廠房的產能擴充及營運能力上升，引線框架業務於第二季度之營業額創出歷史新高。儘管期內集團客戶的資本性投資並不龐大，受惠於沖壓框架及 QFN 蝕片框架需求持續穩定增長，集團引線框架業務於二零零五年上半年佔營業額19.5%。集團引線框架營運的策略性調整按計劃順利推行，於馬來西亞 Johor Bahru 的廠房現正處理整個蝕片框架電鍍後工序，而新設的電鍍生產線亦正由集團客戶進行品質審核。待集團於年底前完成把所有電鍍工序遷往馬來西亞新廠房，經擴大後的產能將可進一步提升集團的成本效益及蝕片框架產量。

除繼續致力維持各項設備產品於健康均衡的水平，近月的市場復甦令焊線機的需求上升。我們被譽為最具成本效益的焊線機及其生產量為單焊接器焊線機兩倍的 Twin Eagle，以及世上首部具30微米直線墊距焊接能力的焊線機 Eagle 60 AP 均已進入量產階段，質量亦廣獲集團客戶認同。於過去數月內，多層微細管芯及300毫米晶片技術為集團提供新機會以擴闊管芯焊機的客戶基礎。我們推出了特別為高密度框架而設的高彈性、低成本(系統及模具)的塑封系統 — Osprey。在五月舉行的新加坡半導體展覽會中，集團演示了為前線裝嵌工序而設，由我們的管芯焊機、雙焊線器焊線機及 Osprey 塑封系統組成的高靈活性製造系統(FMS)，並取得客戶的正面評價。儘管 Osprey 系統的生產量較目前傳統的自動製模系統為低，其較小型鑄模卻能有效地縮短交貨時間及降低模具成本，對應用於包裝設計、試驗性生產線及小批額生產上最為理想。因此，此獨特的 FMS 將可與集團於過去兩年為 CMOS 影像感應組裝而設計的廠房自動化方案 IDEALine 一起使用，以配合高產量客戶的需求。此外，我們再一次被 Advanced Packaging 雜誌評選為二零零五年焊接、塑封及基層貼裝(substrate mounting)組別的高科技包裝獎冠軍，充分顯示業界對 ASM 於技術及創新設備產品的領導地位之肯定及認同。

ASM 一直致力為客戶提供最佳方案，務求在充滿競爭的營商環境中鞏固集團的領導地位。為滿足現今客戶對多元化包裝種類及應用的需求，適用於任何裝嵌工序的複合應用平台亦應運而生，包括如集團具成本效益的 Twin Eagle 及配備超微距焊線技術的 Eagle 60 AP 金線焊機。同樣地，我們的管芯焊機、覆晶焊機、塑封系統及試驗操作產品亦備有類似的複合平台。儘管我們需在短的交貨期內為客戶生產標準產品，然而由於近季度的需求上升及複合平台的原故，集團半製成品及原料的存貨量相對前六個月市場疲弱時有所增加。此外，原材料數量亦隨著客戶訂單上升而有所增加，令集團於二零零五年六月三十日的期末存貨上升至六億七千萬港元，使年度化之存貨周轉率為4.76(二零零四年：7.06)。儘管集團實行一貫的應收賬項管理，但由於過去六個月商業活動呈現上升趨勢，這不但影響存貨周轉率，亦使平均收賬期達96.4日。隨著營運資金上升，再加上經營收益，集團仍錄得自由現金流量(Free Cash Flow)為一億二千六百三十萬港元，而過去六個月的投入資本回報率則為20.8%。

在二零零五年四月派發上年度末期股息四億零四百五十萬港元、及支付二零零五年上半年的資本性投資九千五百八十萬港元後，鑑於期內正現金流量強勁，集團於二零零五年六月三十日的現金淨值達五億二千零五十萬港元。集團流動比率維持在2.8水平，並沒有長期借貸及銀行貸款，股本負債比率亦僅為34.0%。由於集團短期內沒有重大現金開支，並從營運活動持續產生正現金流量，ASM 管理層建議持續派發高息以回饋剩餘現金予集團的股東。

展望

美國半導體行業協會(SIA)報告顯示，消費者應用半導體之銷售於二零零四年首次超越企業應用之銷售。未來，晶片行業之發展將更受宏觀經濟及消費市場所影響。由於電子終端產品持續需要更多功能及更卓越之性能，因而刺激半導體的需求。按現時之市場展望，大部份行業分析員(SIA、WSTS、Dataquest、iSuppli 及 VLSI Research)均預測半導體行業在二零零五年將錄得溫和單位數字增長(介乎5%至6%)，而二零零六年將有接近10%的較高增長率。根據二零零五年電子時報(Electronic Trend Publication)預測，集成電路產量於二零零四至二零零九年期間之複合年增長率將達9.31%。

因應市場對高性能、多元化功能、減低成本及產品體積之需求，尤其是多功能之手提產品，越來越多集成電路組合在設計上均應用了更微細之管線寬度、晶積度尺寸 (QFN) 及晶片大小 (覆晶)、多層管芯、多層包裝及組裝系統 (SIP)，令市場對新一代裝嵌設備之需求更加殷切。今年二月為裝嵌設備行業的轉捩點，市場於過去數月錄得溫和回升。大部份專家 (SEMI及Dataquest) 預測市場未來將持續增長，由二零零五年介乎16.5%至26.4%之負增長，回升至未來兩個年度雙位數字之正增長 (介乎15%至30%)。

儘管管理及開發多元化產品以迎合不同市場之挑戰較大，集團多年來一直貫徹此經營理念，促使集團蓬勃發展，並較主要競爭對手更能經得起行業起伏之考驗。要在瞬息萬變的市場環境下維持領導地位為長期的鬥爭，擁有更豐富資源及更多世界級產品便有絕對的優勢。集團自二零零二年起便成為裝嵌及包裝設備行業最高收益的企業，但我們一直貫徹將設備營業額的10%用於研發的策略，縱使在短期銷售波動時亦如是。集團於研發上的投入於過去三年持續增加，正反映集團的研發專才隊伍正不斷增加 (目前共有600名員工) 及對研發新產品的投入。因此，ASM於二零零四年之研發費用高踞行內第二位，並較集團於二零零一年之開支增加58%。相反，於該三年間，集團主要競爭對手之研發費用按其匯報之貨幣計算則一直在縮減，彼等於二零零四年之研發費用較二零零一年之費用縮減約42%至81%。

管理層相信憑藉我們對設施、研發及員工培訓方面積極及貫徹如一的投資策略，將可為集團帶來更強大的競爭優勢及相應可觀的回報。二零零五年合共港幣二億元的資本性投資將會按計劃進行，用作進一步加強集團之研發分析設備及資訊科技基礎建設、支援產品開發的快速部件樣品製作，以及為馬來西亞廠房添置模具及電鍍設施。

憑藉於機動控制及線性馬達方面的先進技術，集團將於不久將來推出新型號的鋁線焊機及離散 (discrete) 管芯焊機。為維持集團過去二十載於晶片直接封裝 (COB) 應用市場所建立的領導地位，集團預期於二零零五年中，其新一代的鋁線焊機將可進入量產階段，這新型號之產能將較現有型號高出20%至30%，為客戶締造無可比擬的成本效益。同時，集團備有線性馬達焊接器、每小時可焊接20,000個微細管芯的新一代離散 (discrete) 管芯焊機亦將於下半年度進行應用測試。再加上高度靈活的 Osprey 塑封工序設備系統 (如業務回顧部分所述)，集團一直致力更新產品組合及擴闊產品的應用範圍，以發掘於集成電路包裝市場的新機遇。

具備提供綜合包裝解決方案及世界級產品的能力為集團鞏固與主要客戶之策略性夥伴關係的關鍵。面對低k電介體焊接、有源電路、銅線焊接及更薄晶片等新挑戰，ASM繼續為客戶提供工序提升方案以滿足此等需要，並廣受讚賞。透過應用ASM的設備及引線框架，集團為客戶提供生產自動化及包裝發展方案，包括影像感應組件、QFN包裝、高亮度LED、RFID、智能卡、堆疊封裝 (PoP) 等，為客戶提供卓越的建議。此外，集團新的設備管理軟件有助客戶更有效管理資產、並提供遙距方案下載、機械表現追蹤及進度監察功能。我們嶄新的解決方案銷售模式令集團於芸芸競爭對手中脫穎而出，並提升市場滲透率，以進一步拓展業務。

憑藉多年來羅致了眾多技術及管理專才，行之有效的客戶主導策略，及業內最具效益之成本架構以及最多樣化之產品種類，ASM已佔據有利位置，迎接市場上種種競爭。管理層相信，在持續改善之市況下，ASM於二零零五年之表現將繼續超越同儕，維持領導地位。

企業管治

本集團已全部採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之守則條文，惟有以下偏離行為：

1. 本公司董事會現正制定薪酬委員會的組成及權責範圍，並預計於本年九月上旬在預定的董事會會議時完成。
2. 本集團最近發佈備忘錄給僱員，就有關僱員買賣本公司股份提供指引及程序。
3. 董事會最近已制定列載必須由董事會作決定的事項計劃表。
4. 全部非執行董事並無特定任期，但須在公司股東週年大會輪換卸任及須再次參選方可連任。

本集團已採納程序規管董事進行本公司股份交易，以符合上市規則附錄十所載的《標準守則》。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，彼等於審計、法律事宜、商業、會計、企業內部監控及監管事務方面擁有豐富經驗。

賬目審閱

審核委員會聯同本集團的核數師已審閱集團截至二零零五年六月三十日止六個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本期間，本公司並無贖回任何其上市證券，本公司及其任何附屬公司於本期間內亦並無購買或出售本公司之上市證券。

董事會

於本公布日期當日，本公司董事會共有三名獨立非執行董事，分別為 Orasa Livasiri 小姐、鄧冠雄先生及李兆雄先生，三名執行董事為 Arthur H. del Prado 先生（主席）、林師龐先生及馮樹根先生。

承董事會命
董事
林師龐

香港，二零零五年七月二十六日

請同時參閱本公佈於（香港經濟日報及信報）刊登的內容。